

プリント配線板技術ロードマップ特別編 ガラス・サブストレート技術ロードマップ

次の15年のパッケージングを牽引するガラス・サブストレート Glass substrates to drive packaging for the next 15 years

販売価格

Sales Price

JPCA/JEITA/JIEP 会員様特別価格

JPCA/JEITA/JIEP members

¥ **22,000** (税込)
(¥22,000 including tax)

非会員価格

Non-member company

¥ **44,000** (税込)
(¥44,000 including tax)

改訂ポイント

Revision points

2023年9月のIntel Innovation Dayでのガラス・サブストレート開発の発表は、長い間水面下で研究開発活動を行ってきた関係者にとっての追い風となっただけでなく、Intel との取引を希望する設備業者や材料業者のみならず、Intel のライバル企業にも大きな衝撃を与えた。2024年3月には Samsung Electronics が Intel に対抗して2026年にはガラス・サブストレートの量産を開始する計画を発表した。さらに、経済産業省はガラス・サブストレートの重要性を認識し、ガラス・サブストレート生産基盤整備として設備投資の補助を行うことを2024年度予算に組み込んだ。

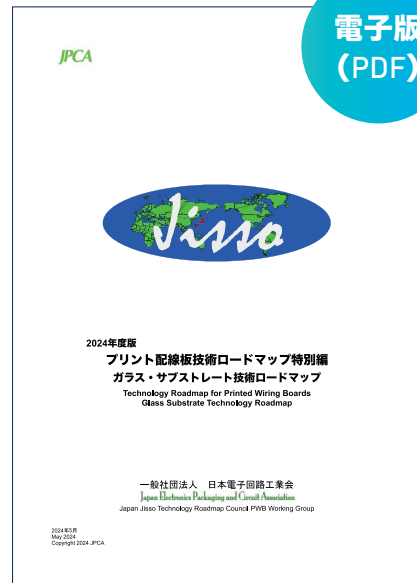
我が国では、半導体、電子部品およびプリント配線板関連の部材と設備を供給するサプライ・チェーンに加え、半導体パッケージ・サブストレート事業における工程外注を含めた幅広い製造基盤が確立されている。しかし、ガラス・サブストレート製造技術は、半導体 BEOL(Backend of Line) 工程の製造技術をプラットフォームとしなければその潜在的な特性を十分に発揮することができないため、業界再編成の可能性を秘めている。

プリント配線板技術ロードマップでは、2年ごとに10年先のプリント配線板のあるべき姿の仮説を提示してきた。しかし、2023年からのガラス・サブストレートへの急速な期待の高まりを受けて、今回ガラス・サブストレート技術ロードマップの特別編を策定し、現時点で入手可能な情報と技術の方向性の仮説を提示することとした。

The announcement of the glass substrate development at the Intel Innovation Day in September 2023 was a tailwind for those involved in R&D activities that have long gone unnoticed. In addition, the announcement had a significant impact not only on equipment suppliers and materials vendors wishing to do business with Intel, but also on Intel's rivals. In March 2024, Samsung Electronics announced plans to start volume production of glass substrates in 2026 to compete with Intel. Furthermore, the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) recognized the importance of glass substrates and included subsidies for capital investment in the 2024 budget as part of the development of glass substrate production infrastructure.

In Japan, in addition to the supply chain that provides materials and equipment related to semiconductors, electronic components and printed wiring boards, a broad range of manufacturing infrastructure has been established, including subcontracted processes in the semiconductor packaging substrate business. However, the glass substrate manufacturing technology has the potential to reorganize the industry, as its potential characteristics cannot be fully exploited without using the semiconductor BEOL (Backend of Line) process manufacturing technology as a platform.

In the technology roadmap for PWBs, we have presented a hypothesis of what the PWB should be every two years for the next 10 years. However, in response to the rapid increase in expectations for glass substrates from 2023, a special edition of the glass substrate technology roadmap has been drawn up, presenting the information available at the present time and hypotheses on the direction of the technology.



記載言語：日本語

Language: Japanese only

発行日：2024年6月1日



<https://jpca.jp/pwb-roadmap/>

JPCA

2024年度版 プリント配線板技術ロードマップ特別編専用申込書

Application form for 2024 Edition Technology Roadmap for PWBs Glass Substrate Technology Roadmap

こちらはダウンロード版(PDF形式)です

This publication is the download version (PDF) only. For companies located overseas, a paper version is available.

お申込方法 How to apply

1. FAX でのご注文 下記の申込書に必要事項をご記入の上、お申込み下さい

Order by fax Please fill out the application form below.

2. E-mail でのご注文 下記の申込書に必要事項をご記入し、E-mail に添付の上、お送り下さい。

Order by E-mail Please fill out the application form below and attach it to the e-mail.

ご注文を受け付け後、ダウンロードURLを申込書記載のメールアドレスにご案内いたします。

For overseas companies, we will contact you after receiving your order by e-mail.

支払方法を銀行振込ご選択の場合は、請求書をPDFにてご案内いたします。

郵便振替の場合は請求書と払込取扱票を、クレジットカード払いの場合は納品書と

カード請求控えを郵送いたします。

Application date year month date
お申込日： 年 月 日

① 会員区分(当てはまる方へチェックをお願いします)

Membership category (Please check the relevant items)

会員企業 価格22,000円(税込)
JPCA/JEITA/JIEP members ¥22,000 including tax

非会員企業 価格44,000円(税込)
Non-member company ¥44,000 including tax

該当団体名にチェックを入れて下さい
Please check the relevant organization.

JPCA JEITA JIEP

JIEP個人会員の方は必ず会員番号をご記入ください。

JIEP個人会員番号 ()

会員番号がご不明な方は、下記URLよりお問い合わせください。

<https://web.jiep.or.jp/inquiry.html>

② ご送付先(枠内をきれいに記入下さい)

Mailing / Sending Address (Please fill out the following form)

お申込者記入欄	住所 Address	〒 -		
	会社名 Company name			
	所属部署 Department of affiliation	役職 Post		
	氏名 Name	TEL		
	E-mail			

上記の送付先と請求書の送付先が異なるときは、下記にご記入下さい。

If the above address is different from the invoice address, please fill in the following.

お申込者記入欄	住所 Address	〒 -		
	会社名 Company name			
	所属部署 Department of affiliation	役職 Post		
	氏名 Name	TEL		
	E-mail			

③ お支払方法(チェックをお願いします)

Payment Method (For overseas companies, please choose bank transfer or credit card. We will send you an invoice.)

銀行振込 郵便振替 クレジットカード払い
Bank transfer Credit card

※クレジットカード払いをご希望の場合は後日事務局よりご連絡いたします。

お問い合わせ・お申込先 Contact and application destination

一般社団法人 日本電子回路工業会 Japan Electronics Packaging and Circuits Association(JPCA)

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2階 総務部

Kairo Kaikan 2F. 3-12-2, Nishigigita Suginami-ku, Tokyo167-0042 Japan

TEL : 03-5310-2020 FAX : 03-5310-2021 E-mail : book@jpca.org

●個人情報の取り扱いについて About the handling of personal information

今回ご記入いただきました個人情報は、諸手続きにのみ使用させていただきます。ご本人の承諾がない限り、第三者に開示することはありません。

The personal information given in this form will be used only for necessary procedures. It will not be disclosed to a third party without the consent.